

半導体組立・パッケージング

➤ 対応製品

- LD,PD,LED,VCSEL、各種センサーなど、小チップを得意としております。

➤ 対応パッケージ

- TO-5、TO-46、TO-56などTO-CANメタルパッケージ、セラミックパッケージも対応可

➤ 対応範囲

- 光半導体(LD,LED,PD) ・光センサ ・各種評価用試作
- ダイボンディング、ワイヤボンディング (COS、COC等)
- 単工程加工：チップ付(ダイボンディング),ワイヤ付 (ワイヤボンディング),パッケージング、各種試験等



➤ 保有設備・施設

- クリーンルーム (クラス 10,000)
- 自動 3 次元ダイスボンダー、自動 3 次元ワイヤボンダー
- 自動調芯パッケージング装置
- プロジェクション溶接機、シーム溶接機
- Heリーク試験、グロスリーク試験
- バーンイン槽、温度特性評価装置、温度サイクル槽
- 真空バーク炉、各種手動ボンダー、他

光通信用デバイス組立



➤ 対応製品

- TOSA、ROSA、可視光レーザーモジュールなど
- レセクタブル、ピグテールタイプなど

➤ 対応範囲

- 光通信分野から可視光レーザーのエレクトロニクス分野まで対応可能
- 空間光結合技術により光半導体と光ファイバーのモジュール化を行います。



➤ 信頼性評価

- TO-8、COS、COCの組立からバーンイン、エージング、湿熱試験等の長期信頼性評価を行います。

